

74310 Mikroelektroniikan pakkaustekniikka
prof. Eero Ristolainen



TENTTI 22.1.2001

Kirjallisuuden käyttö kielletty

1. Kerro lyhyesti mitä seuraavilla termeillä tarkoitetaan (yht. 6 p):
 - a) DCA
 - b) CSP
 - c) TAB
2. Esittele lyhyesti eri MCM-tekniikat. (6 p)
3. Passiivikomponenttien integrointi puolijohteelle. (6 p)
4. Mitä vaatimuksia optoelektroniikka asettaa pakkaustekniikalle? (6 p)
5. Välitäreaineiden (eli underfillien) käyttö elektroniikkakokoonpanoissa. (6 p)